

スマートプロセス学会誌

目 次 *Vol. 15 No. 1* 2026 (令和 8 年 1 月)

Mate2025 特集号 一第31回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム

会 告		N1
学 海	「総合知」を生み出す場とは 田中 学.....	1
卷 頭 言	Mate2025 特集号によせて 安藤哲也.....	2
特 集		
研究論文	透明有機電気化学トランジスタの高伸長化構造と生体計測応用 阿部岳晃・松田尚也・栗平直子・秋山実邦子 植村隆文・関谷 毅・荒木徹平.....	3
	Cu 核 Sn-Bi はんだボールのエレクトロマイグレーション挙動 松藤貴大・須藤皓紀・出井寛大.....	9
	Sn-Zn はんだシートを用いた Cu/Cu 接合強度に及ぼす ギ酸・酢酸塩被膜処理時間の影響 井上岳斗・山崎浩次・小山真司.....	17
	金属塩被膜処理した Sn-Zn はんだシートの長期保管性評価 山崎浩次・井上岳斗・小山真司.....	21
	Ag-Sn 液相拡散接合材料の特性と接合挙動解析 岸本貴臣・竹内順一・馬場秀斗・小山真司.....	26
	ハイブリッド接合におけるウエハ接合強度面内均一性評価法の検討 小林大季・布施淳也・近藤悠介・吉原佑樹 佐野麻理恵・井上史大.....	31
	Al 板の超音波接合挙動の予測に向けた熱－構造－音響解析技術の開発 久保 悠・相澤隆博・篠原勇人・東條 啓.....	36
報告記事	エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術シンポジウム (Mate2025) 開催報告 濱田真行.....	43
会報・掲示板		N4

Journal of Smart Processing
Vol. 15 No. 1 2026 (January 2026)

CONTENTS

Special Issue on 31st Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics” (Mate2025)

S.P.S.Announcement..... N1

Preface
Manabu TANAKA.....1

Preface of Feature Article
Special Issue on “Mate2025”
Tetsuya ANDO.....2

Feature Articles

Regular Research Articles

Highly Stretchable Architecture of Transparent Organic Electrochemical Transistors
for Biological Measurements
Takaaki ABE, Shohya MATSUDA, Naoko KURIHIRA, Mihoko AKIYAMA,
Takafumi UEMURA, Tsuyoshi SEKITANI and Teppei ARAKI.....3

Electromigration Behavior of Cu-Cored Sn-Bi Solder Balls
Takahiro MATSUFUJI, Hiroki SUDOH and Kanta DEI.....9

Effect of Formate and Acetate Coating Time on Cu/Cu Joint Strength Using Sn-Zn Solder Sheet
Gakuto INOUE, Koji YAMAZAKI and Shinji KOYAMA.....17

Evaluation of the Storage Stability of Sn-Zn Solder Sheets Coated with a Metal Salt Film
Koji YAMAZAKI, Gakuto INOUE and Shinji KOYAMA.....21

Characteristics and Bonding Behavior Analysis of
Ag-Sn Transient Liquid Phase Diffusion Bonding Material
Takaomi KISHIMOTO, Junichi TAKEUCHI, Shuto BABA and Shinji KOYAMA.....26

Measurement Methods of Within-Wafer Bond Strength Uniformity for Hybrid Bonding
Daiki KOBAYASHI, Junya FUSE, Yusuke KONDO, Yuki YOSHIHARA,
Marie SANO and Fumihiro INOUE.....31

Development of Thermo-Mechanical-Acoustic Analysis for
Predicting Ultrasonic Bonding Behavior of Aluminum Plates
Haruka KUBO, Takahiro AIZAWA, Yuto SHINOHARA and Akira TOJO.....36

Special Report

Report on 31st Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics”
Naoyuki HAMADA.....43

S.P.S.News..... N4